

tesa HAF® 8410 HS

Information Produit



Film activable à chaud pour l'intégration des modules dans les cartes à puces

Description produit

tesa® HAF 8410 HS est un film adhésif brun double face activable à chaud composé de résine phénolique réactive et de caoutchouc nitrile.

Application

tesa® HAF 8410 HS est conçu pour l'intégration de modules dans les cartes à puces en réponse à des exigences de grande sécurité et de longue durée de vie.

- · convient pour les cartes PVC, ABS, PET et PC
- facilement utilisable sur toutes les lignes de production courantes
- · résistance remarquable au vieillissement
- très grande souplesse grâce au contenu important de caoutchouc

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

•	Support	aucun	•	Epaisseur totale	60 µm
•	Type de masse adhésive	caoutchouc nitrile/	•	Couleur	ambre
		résine phénolique			

• Type de protecteur glassine

Propriétés / Valeurs de performance

•	Pouvoir adhésif (cisaillement	12 N/mm ²	•	Pouvoir adhésif (par poussée	12 N/mm ²
	dynamique)			verticale)	

Infos complémentaires

Recommandations techniques pour les applications sur cartes à puces:

Les valeurs suivantes sont recommandées pour le paramétrage des machines. Cependant, les paramètres optimaux dépendent du type de machine, de la particularité des supports de cartes et modules ainsi que des exigences des clients.

• Pré laminage :

L'adhésif est laminé sur le module. Cette étape peut être faite en ligne ou en dehors. L'étape de pré-laminage n'affecte pas la durée de conservation. Les rouleaux de modules laminés se conservent comme l'adhésif seul.

Paramètres de la machine



tesa HAF® 8410 HS

Information Produit

Infos complémentaires

• Température: 120 – 140°C

Pression: 4 – 6 bar
Durée: 1,5 – 3,0s

• Implantation du module :

Pendant l'étape d'implantation, les modules ayant été prédécoupés, sont placés dans les cavités crées à cet effet et collés de façon permanente sur le corps de carte. Pour cette étape, les paramétrages dépendent du type de ligne utilisée. Aujourd'hui, deux procédés sont couramment utilisés :

Procédé en une seule étape (machine à basse température):

température: 160-180°Cpression: 65 N/module

durée: 2,0 -4,0s

Procédé en une seule étape (machine à haute température):

température: 180-200°Cpression: 65 N/module

durée: 1,0 - 1,5s

Procédé à plusieurs étapes avec 2 ou plusieurs pressions à chaud:

température: 170-200°Cpression: 65 N/module

• durée pour chaque étape: 0,7 - 1,2s

Les températures sont mesurées sur le tampon chauffant

Pour d'autres applications que les cartes à puces, d'autres paramètres machine doivent être utilisés. Les conditions de stockage sont faites selon les conditions de la gamme HAF.

Note: les valeurs de pouvoir adhésif sont obtenues selon des conditions standard en laboratoire (valeurs moyennes). Les valeurs sont garanties et données pour chaque numéro de lot (matériel: pièce en aluminium repéré/conditions de collage: température: 120°C; pression: 10 bar; durée: 8 min



tesa HAF® 8410 HS

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

